MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 41, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2014.

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico – PPB de UNIDADE DE ENTRADA, TECLADO PARA RASTREADOR COM OU SEM SAÍDA DE VÍDEO INCORPORADA**.**

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria do Desenvolvimento da Produção, no endereço:

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3335

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes *e-mails*: cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mct.gov.br e cgapi@suframa.gov.br.

HELOISA REGINA GUIMARÃES DE MENEZES
Secretária do Desenvolvimento da Produção

ANEXO

I. ALTERAR A REDAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA UNIDADE DE ENTRADA, TECLADO PARA RASTREADOR COM OU SEM SAÍDA DE VÍDEO INCORPORADA, ESTABELECIDO PELO ARTIGO 1º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 24, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2007:

DE:

Art. 1º Estabelecer para o produto UNIDADE DE ENTRADA, TECLADO, PARA RASTREADOR COM OU SEM SAÍDA DE VÍDEO INCORPORADA o seguinte Processo Produtivo Básico:

I - injeção das peças plásticas;
II - montagem e soldagem, ou processo equivalente, dos componentes nas placas de circuito impresso;
III - montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e
IV - montagem final.

PARA:

Art. 1º Estabelecer para o produto UNIDADE DE ENTRADA, TECLADO, PARA RASTREADOR COM OU SEM SAÍDA DE VÍDEO INCORPORADA o seguinte Processo Produtivo Básico:

I - injeção das peças plásticas;
II – fabricação das placas de circuito impresso a partir do laminado em percentual mínimo de 80%(oitenta por cento), a partir de 1º de julho de 2015;
III – montagem e soldagem, ou processo equivalente, dos componentes nas placas de circuito impresso;
IV - montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e
IV - montagem final.